

2021年中国高端电子封装材料行业分析报告- 产业规模现状与发展定位研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国高端电子封装材料行业分析报告-产业规模现状与发展定位研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202112/563088.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

电子封装就是安装集成电路内置芯片外用的管壳，起着安放固定密封，保护集成电路内置芯片，增强环境适应的能力，并且集成电路芯片上的铆点也就是接点，是焊接到封装管壳的引脚上的，它所用材料都是陶瓷，玻璃以及金属。

高端电子封装材料行业涵盖领域广、应用行业跨度大，是新材料产业体系中的前沿、关键材料领域，是支撑中国制造实现突破的基础之一，对我国集成电路、智能终端、光伏制造、新能源电池等产业发展具有显著的助力作用，是我国重点支持和发展的行业之一。

目前党中央以及国务院、发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境，例如：2020年中国共产党第十九届中央委员会发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；同年国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8号）等。

高端电子封装材料行业相关法律法规和政策

日期	相关部门	政策名称	主要内容
2020年	中国共产党第十九届中央委员会	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	提出了要“加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”，指明了“十四五”时期发展壮大战略性新兴产业的方向和重点领域，既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性谋划布局一批新产业。如：发展先进无机非金属材料、高性能复合材料、新型功能稀土材料、信息功能材料、纳米材料等前沿新材料，实施材料基因工程，加快建设材料强国。
2020年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8号）	指出集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。进一步提出财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等多方面鼓励政策。
2020年	发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409号）	文件明确了聚焦重点产业投资领域，包括加快新材料产业强弱项。将围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。
2020年	国务院	《关于印发<新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）>的通知》（国办发〔2020〕39号）	提出到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能

源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用；加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。 2019年 工信部

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》（工信部原〔2019〕254号）将电子化工新材料与特种橡胶及其他高分子材料列入先进化工材料。 2019年 工信部《GB/T37264-2018新材料技术成熟度等级划分及定义》该标准充分考虑了材料从实验室研制到工业批产各个阶段的实际情况，将新材料的技术成熟度划分为实验室、工程化和产业化三个阶段的九个等级，同时界定了成熟度划分的等级条件、划分依据、判定规则等内容。该标准适用于新材料技术成熟度评价。 2018年 工信部、财政部

《国家新材料产业资源共享平台建设方案》（工信部联原〔2018〕78号）提出：到2020年，围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。到2025年，新材料产业资源共享服务生态体系更加完善。 2018年

质检总局、工信部、发改委等多部委

《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》（国质检标联〔2018〕77号）构建新材料产业标准体系，研制新材料“领航”标准，含先进半导体和新型显示材料。

2018年 国家知识产权局

《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》（国知发协函字〔2018〕9号）确定了10个重点产业，细化为62项细分领域，明确了国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。其中包括：先进电子材料。 2017年 工信部、发改委、科技部、财政部

《信息产业发展指南》（工信部联规〔2016〕453号）要重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的新型智能手机、平板电脑、车载智能设备以及人工智能等终端产品，提升产品的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞争力。 2017年 发改委

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》

将高性能密封材料作为新兴功能材料产业列入指导目录。 2017年 科技部

《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》（国科发高〔2017〕89号）提出重点任务“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“封装测试”：面向移动互联和汽车电子等重大领域需求，围绕处理器、存储器、14-10纳米工艺节点晶圆等产品开发下一代封装集成与测试新技术以及相关的关键装备和材料产品；建成有影响力的封装集成产业共性技术研发平台，取得较完善的知识产权体系。 2016年 国务院

《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》（国发〔2016〕43号）提出深入实施国家科技重大专项的相关要求：极大规模集成电路制造装备及成套工艺。研发14纳米逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术，开展75纳米关键技术研究，形成28-14纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链，整体创新能力进入世界先进行列。 2016年

工业和信息化部

《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕318号）

提出在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。

2015年 国务院《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）提出瞄准新材料等战略重点，在新材料领域，要以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，同时加快基础材料升级换代。 2014年

中国胶粘剂和胶粘带工业协会《中国合成胶粘剂和胶粘带行业“十三五”发展规划》提出：“十三五”期间，重点发展的产品应该是环保性及功能性兼备的热熔胶、水基胶、光固化胶等，限制溶剂型胶粘剂的发展速度，特别提出要发展建筑节能用胶和膜、医用压敏胶（带）、电子胶及电子封装胶、汽车和高铁用胶和膜等具体项目。

资料来源：观研天下整理（LC）

观研报告网发布的《》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章2017-2021年中国高端电子封装材料行业发展概述

第一节 高端电子封装材料行业发展情况概述

- 一、高端电子封装材料行业相关定义
- 二、高端电子封装材料行业基本情况介绍
- 三、高端电子封装材料行业发展特点分析

四、高端电子封装材料行业经营模式

- 1、生产模式
- 2、采购模式
- 3、销售/服务模式

五、高端电子封装材料行业需求主体分析

第二节 中国高端电子封装材料行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、高端电子封装材料行业产业链条分析
- 三、产业链运行机制
 - (1) 沟通协调机制
 - (2) 风险分配机制
 - (3) 竞争协调机制

四、中国高端电子封装材料行业产业链环节分析

- 1、上游产业
- 2、下游产业

第三节 中国高端电子封装材料行业生命周期分析

- 一、高端电子封装材料行业生命周期理论概述
- 二、高端电子封装材料行业所属的生命周期分析

第四节 高端电子封装材料行业经济指标分析

- 一、高端电子封装材料行业的赢利性分析
- 二、高端电子封装材料行业的经济周期分析
- 三、高端电子封装材料行业附加值的提升空间分析

第五节 中国高端电子封装材料行业进入壁垒分析

- 一、高端电子封装材料行业资金壁垒分析
- 二、高端电子封装材料行业技术壁垒分析
- 三、高端电子封装材料行业人才壁垒分析
- 四、高端电子封装材料行业品牌壁垒分析
- 五、高端电子封装材料行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球高端电子封装材料行业市场发展现状分析

第一节 全球高端电子封装材料行业发展历程回顾

第二节 全球高端电子封装材料行业市场区域分布情况

第三节 亚洲高端电子封装材料行业地区市场分析

- 一、亚洲高端电子封装材料行业市场现状分析
- 二、亚洲高端电子封装材料行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲高端电子封装材料行业市场前景分析

第四节 北美高端电子封装材料行业地区市场分析

- 一、北美高端电子封装材料行业市场现状分析
- 二、北美高端电子封装材料行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美高端电子封装材料行业市场前景分析

第五节 欧洲高端电子封装材料行业地区市场分析

- 一、欧洲高端电子封装材料行业市场现状分析
- 二、欧洲高端电子封装材料行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲高端电子封装材料行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界高端电子封装材料行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球高端电子封装材料行业市场规模预测

第三章 中国高端电子封装材料产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国高端电子封装材料行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国高端电子封装材料产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 中国高端电子封装材料行业运行情况

第一节 中国高端电子封装材料行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国高端电子封装材料行业市场规模分析

第三节 中国高端电子封装材料行业供应情况分析

第四节 中国高端电子封装材料行业需求情况分析

第五节 我国高端电子封装材料行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国高端电子封装材料行业供需平衡分析

第七节 中国高端电子封装材料行业发展趋势分析

第五章 中国高端电子封装材料所属行业运行数据监测

第一节 中国高端电子封装材料所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国高端电子封装材料所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国高端电子封装材料所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国高端电子封装材料市场格局分析

第一节 中国高端电子封装材料行业竞争现状分析

一、中国高端电子封装材料行业竞争情况分析

二、中国高端电子封装材料行业主要品牌分析

第二节 中国高端电子封装材料行业集中度分析

一、中国高端电子封装材料行业市场集中度影响因素分析

二、中国高端电子封装材料行业市场集中度分析

第三节 中国高端电子封装材料行业存在的问题

第四节 中国高端电子封装材料行业解决问题的策略分析

第五节 中国高端电子封装材料行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章2017-2021年中国高端电子封装材料行业需求特点与动态分析

第一节 中国高端电子封装材料行业消费市场动态情况

第二节 中国高端电子封装材料行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 高端电子封装材料行业成本结构分析

第四节 高端电子封装材料行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国高端电子封装材料行业价格现状分析

第六节 中国高端电子封装材料行业平均价格走势预测

一、中国高端电子封装材料行业价格影响因素

二、中国高端电子封装材料行业平均价格走势预测

三、中国高端电子封装材料行业平均价格增速预测

第八章2017-2021年中国高端电子封装材料行业区域市场现状分析

第一节 中国高端电子封装材料行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区高端电子封装材料市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区高端电子封装材料市场规模分析

四、华东地区高端电子封装材料市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区高端电子封装材料市场规模分析

四、华中地区高端电子封装材料市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区高端电子封装材料市场规模分析

四、华南地区高端电子封装材料市场规模预测

第五节 华北地区高端电子封装材料市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区高端电子封装材料市场规模分析

四、华北地区高端电子封装材料市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区高端电子封装材料市场规模分析

四、东北地区高端电子封装材料市场规模预测

第七节 西部地区市场分析

一、西部地区概述

二、西部地区经济环境分析

三、西部地区高端电子封装材料市场规模分析

四、西部地区高端电子封装材料市场规模预测

第九章 2017-2021年中国高端电子封装材料行业竞争情况

第一节 中国高端电子封装材料行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国高端电子封装材料行业SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国高端电子封装材料行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 高端电子封装材料行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章2021-2026年中国高端电子封装材料行业发展前景分析与预测

第一节 中国高端电子封装材料行业未来发展前景分析

一、高端电子封装材料行业国内投资环境分析

二、中国高端电子封装材料行业市场机会分析

三、中国高端电子封装材料行业投资增速预测

第二节 中国高端电子封装材料行业未来发展趋势预测

第三节 中国高端电子封装材料行业市场发展预测

- 一、中国高端电子封装材料行业市场规模预测
- 二、中国高端电子封装材料行业市场规模增速预测
- 三、中国高端电子封装材料行业产值规模预测
- 四、中国高端电子封装材料行业产值增速预测
- 五、中国高端电子封装材料行业供需情况预测

第四节 中国高端电子封装材料行业盈利走势预测

- 一、中国高端电子封装材料行业毛利润同比增速预测
- 二、中国高端电子封装材料行业利润总额同比增速预测

第十二章2021-2026年中国高端电子封装材料行业投资风险与营销分析

第一节 高端电子封装材料行业投资风险分析

- 一、高端电子封装材料行业政策风险分析
- 二、高端电子封装材料行业技术风险分析
- 三、高端电子封装材料行业竞争风险分析
- 四、高端电子封装材料行业其他风险分析

第二节 高端电子封装材料行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章2021-2026年中国高端电子封装材料行业发展战略及规划建议

第一节 中国高端电子封装材料行业品牌战略分析

- 一、高端电子封装材料企业品牌的重要性
- 二、高端电子封装材料企业实施品牌战略的意义
- 三、高端电子封装材料企业品牌的现状分析
- 四、高端电子封装材料企业的品牌战略
- 五、高端电子封装材料品牌战略管理的策略

第二节 中国高端电子封装材料行业市场的重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国高端电子封装材料行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章2021-2026年中国高端电子封装材料行业发展策略及投资建议

第一节 中国高端电子封装材料行业产品策略分析

一、服务/产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国高端电子封装材料行业营销渠道策略

一、高端电子封装材料行业渠道选择策略

二、高端电子封装材料行业营销策略

第三节 中国高端电子封装材料行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国高端电子封装材料行业重点投资区域分析

二、中国高端电子封装材料行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202112/563088.html>